

特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

（法第 12 条、法施行規則第 56 条）
〔PCT 36 条及び PCT 規則 70〕

REC'D 15 DEC 2005

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 2418PCT37018	今後の手続きについては、様式 PCT/IPEA/416 を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/017467	国際出願日 (日.月.年) 25.11.2004	優先日 (日.月.年) 28.11.2003
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. G05B19/418		
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		

- この報告書は、PCT 35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第 57 条 (PCT 36 条) の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。
- この報告には次の附属物件も添付されている。
 - ☒ 附属書類は全部で 4 ページである。
 - ☒ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙 (PCT 規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)
 - ☐ 第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
 - ☐ 電子媒体は全部で _____ (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。
(実施細則第 802 号参照)
- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
 - ☒ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎
 - ☐ 第 II 欄 優先権
 - ☐ 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 - ☐ 第 IV 欄 発明の単一性の欠如
 - ☒ 第 V 欄 PCT 35 条 (2) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 - ☐ 第 VI 欄 ある種の引用文献
 - ☐ 第 VII 欄 国際出願の不備
 - ☐ 第 VIII 欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 22.09.2005	国際予備審査報告を作成した日 29.11.2005	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官 (権限のある職員) 齋藤 健児	3C 3020
		電話番号 03-3581-1101 内線 3324

様式 PCT/IPEA/409 (表紙) (2005 年 4 月)

第 I 欄 報告の基礎

1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。

- ☒ 出願時の言語による国際出願
- ☐ 出願時の言語から次の目的のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
- ☐ 国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
- ☐ 国際公開 (PCT規則12.4(a))
- ☐ 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条 (PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書

第 1-12 _____ ページ、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☒ 請求の範囲

第 2-3, 5-8, 10-11, 13-14, 16, 18-19 _____ 項、出願時に提出されたもの

第 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの

第 1, 4, 9, 12, 15, 17, 20-22 _____ 項*、22.09.2005 付けて国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ 項*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☒ 図面

第 1-3 ~~ページ~~/図、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル
配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表 (具体的に記載すること) _____

☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) _____

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表 (具体的に記載すること) _____

☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1-19	有
	請求の範囲	20-22	無
進歩性(IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-22	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-22	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 2002-244712 A (バンドー化学株式会社)
・ 2002.08.30, 段落【0033】

文献2: JP 2003-99111 A (株式会社デンソー)
2003.04.04, 段落【0003】、図5

文献3: JP 63-162145 A (株式会社東芝)
1988.07.05, 特許請求の範囲

文献4: 日本国実用新案登録出願2-114097号(日本国実用新案登録
出願公開4-73446号)の願書に添付した明細書及び図面の内容
を記録したマイクロフィルム(三菱重工業株式会社)
1992.06.26, 全文

文献5: JP 2003-271216 A (凸版印刷株式会社)
2003.09.26, 段落【0057】

請求の範囲1-19について

文献1-2の各々には、全体に係る情報と分割段階による相対関係を示す情報とからなる識別情報を各部に記録することが記載されている。

請求の範囲1-19に係る発明は、上記文献1-2の各々に記載された事項と識別情報が各製造主体(各メーカー)における管理及び製造に関する情報を含む他は、本質的な差異はない。

しかしながら、識別情報に、各製造主体における管理及び製造に関する情報を含ませることは、周知である(例えば、文献5参照)。

してみれば、請求の範囲1-19に係る発明は、上記文献1-2の各々に記載された識別情報について、上記周知技術を単に付加したものに過ぎない。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

請求の範囲 20-22 について

文献 1-5 の各々には、情報記録部に、識別情報を記録し、流通させることが記載されている。

識別情報に、各製造主体における管理及び製造に関する情報を含ませることは、周知である（例えば、文献 5 参照）。

請求の範囲

1. (補正後) 基板メーカー(1) で生産した基板を後続する実装メーカー(2) に流通させ、実装メーカーでの部品実装に供することにより回路基板を生産する回路基板の生産方法であって、

1 又は複数の分割段階でそれぞれ複数に分割される多数個取りの基板(5) を用い、かつ各分割段階の分割前と分割後の各基板(5、6、7) にそれぞれ対応させて設けてなる各情報記録部(8、9、10) は各メーカーにおける管理及び製造に関する情報を含む識別情報が参照及び記録可能に構成されており、前記各情報記録部に基板全体に係る情報と各分割段階での分割による相対関係を示す情報とからなる識別情報を記録して、基板メーカーが実装メーカーに基板を流通させる回路基板の生産方法。

2. 情報記録部(8、9、10) には、二次元コードにて情報を記録する請求の範囲第1項に記載の回路基板の生産方法。

3. 基板メーカー(1) で、情報記録部(8、9、10) に各基板(5、6、7) 自体の識別情報に加えて基板メーカーでの生産工程に係る情報と実装メーカー(2) での生産工程に係る情報を記録する請求の範囲第1又は第2項に記載の回路基板の生産方法。

4. (補正後) 基板メーカー(1) で生産され後続する実装メーカー(2) に流通された基板に対し、実装メーカーにて部品を実装して回路基板を生産する回路基板の生産方法であって、

1 又は複数の分割段階でそれぞれ複数に分割される多数個取りの基板(5) を用い、基板メーカーで各分割段階の分割前と分割後の各基板(5、6、7) にそれぞれ対応させて設けてなる各情報記録部(8、9、10) は各メーカーにおける管理及び製造に関する情報を含む識別情報が参照及び記録可能に構成され、基板メーカーにおいて前記各情報記録部に基板全体に係る情報と各分割段階での分割による相対関係を示す情報とからなる識別情報が記録された基板に対し、実装メーカーで各情報記録部に実装メーカーで用いる識別情報を記録する回路基板の生産方法。

5. 基板メーカー(1) で情報記録部(8、9、10) に各基板(5、6、7) 自体の識別情報に加えて実装メーカー(2) での生産工程に係る情報を記録された基板に対し、実装メーカーで情報記録部から読み出した生産工程に係る情報に基づいて実装を行う請求の範囲第4項に記載の回路基板の生産方法。

6. 基板メーカー（１）及び実装メーカー（２）で、各基板（５、６、７）に関する生産工程情報と情報記録部（８、９、１０）から読み出した識別情報とを組み合わせ、通信網（２８）を介して接続されたデータ処理センタ（２９）に送信し、データ処理センタにてデータ処理を行って各種データベース（３０）を構築し、基板メーカー及び実装メーカーは必要なデータを通信網を介してデータベースから取り込んで必要な処理を行う請求の範囲第１項に記載の回路基板の生産方法。

7. 基板メーカー（１）及び実装メーカー（２）で、各基板（５、６、７）に関する生産工程情報と情報記録部（８、９、１０）から読み出した識別情報とを組み合わせ、通信網（２８）を介して接続されたデータ処理センタ（２９）に送信し、データ処理センタにてデータ処理を行って各種データベース（３０）を構築し、基板メーカー及び実装メーカーは必要なデータを通信網を介してデータベースから取り込んで必要な処理を行う請求の範囲第４項に記載の回路基板の生産方法。

8. データベース（３０）には、基板メーカー（１）と実装メーカー（２）の両方における生産履歴に関する情報が含まれる請求の範囲第６又は第７項に記載の回路基板の生産方法。

9. （補正後）基板メーカー（１）で、１又は複数の分割段階でそれぞれ複数に分割されかつ各分割段階の分割前と分割後の各基板（５、６、７）にそれぞれ対応させて情報記録部（８、９、１０）を設けてなる多数個取りの基板（５）を生産し、基板メーカーで生産した基板を後続する実装メーカー（２）に流通させ、実装メーカーにて基板に電子部品を実装して回路基板を生産する回路基板の生産システムであって、

前記情報記録部は各メーカーにおける管理及び製造に関する情報を含む識別情報が参照及び記録可能に構成されており、基板メーカーには基板全体に係る情報と各分割段階での分割による相対関係を示す情報とからなる識別情報を基板の各情報記録部に記録する記録手段（１７）が設けられ、実装メーカーには情報記録部から情報を読み出す読み出し手段（２１、２５）が設けられた回路基板の生産システム。

10. 基板メーカー（１）における記録手段（１７）は、各基板（５、６、７）自体の識別情報に加えて基板メーカーでの生産工程に係る情報と実装メーカー（２）での生産工程に係る情報を情報記録部（８、９、１０）に記録するように構成した請求の範囲第９項に記載の回路基板の生産システム。

11. 基板メーカー（１）及び実装メーカー（２）と通信網（２８）にて接続され、基板メーカー及び実装メーカーから送信されたデータを処理して各種データベース（３０）を構築す

るデータ処理センタ（29）を備え、基板メーカ及び実装メーカに、各基板（5、6、7）の情報記録部（8、9、10）に記録された識別情報を読み出す手段（18、21、25）と、基板メーカ及び実装メーカでの各基板に関する生産工程情報と識別情報とを組み合わせてデータ処理センタに送信するとともに、必要なデータをデータ処理センタから受信するデータ処理・送受信手段（20、27）とを設けた請求の範囲第9又は第10項に記載の回路基板の生産システム。

12.（補正後）1又は複数の分割段階を有し、各分割段階で複数に分割される多数個取り基板（5）であって、

各分割段階の分割前と分割後の各基板（5、6、7）に対応させて設けられた情報記録部（8、9、10）は各メーカ（1、2）における管理及び製造に関する情報を含む識別情報が参照及び記録可能に構成され、前記各情報記録部には基板全体に係る情報と各分割段階での分割による相対関係を示す情報とからなる識別情報が記録された多数個取り基板。

13. 情報記録部（8、9、10）には、基板メーカ（1）と実装メーカ（2）の両方の生産履歴が記録される請求の範囲第12項に記載の多数個取り基板。

14. 情報記録部（8、9、10）には、基板（5、6、7）自体の個別情報に加えて、基板メーカ（1）での生産工程に必要な情報と実装メーカ（2）での生産工程に必要な情報が記録されている請求の範囲第12項に記載の多数個取り基板。

15.（補正後）多数個取り基板（5）を1又は複数の分割段階でそれぞれ複数に分割された基板（6、7）に部品が実装された回路基板であって、

回路基板に設けられた情報記録部（8、9、10）は各メーカ（1、2）における管理及び製造に関する情報を含む識別情報が参照及び記録可能に構成され、前記情報記録部には、多数個取り基板における全基板に共通する情報と各分割段階の分割基板との関係を示す情報とからなる識別情報が記録された回路基板。

16. 情報記録部（8、9、10）には、基板（5、6、7）自体の識別情報に加えて、基板メーカ（1）での生産工程に必要な情報と実装メーカ（2）での生産工程に必要な情報が記録されている請求の範囲第15項に記載の回路基板。

17.（補正後）データ処理センタ（29）において、基板メーカ（1）及び実装メーカ（2）から通信網（28）を介して送信された1又は複数の分割段階でそれぞれ複数に分割される多数個取り基板の各分割段階の分割前と分割後の各基板（5、6、7）に関する生産工程情報と、各基板に設けられ、各メーカにおける管理及び製造に関する情報を含

む識別情報が参照及び記録可能に構成された情報記録部（８、９、１０）から読み出した基板全体に係る情報と各分割段階での分割による相対関係を示す情報とからなる識別情報との組み合わせを、データ処理して各種データベース（３０）を構築する回路基板の生産方法。

１８．データベース（３０）には、基板メーカ（１）と実装メーカ（２）の両方における生産履歴に関する情報が含まれることを特徴とする請求項１７記載の回路基板の生産方法。

１９．データベース（３０）には、基板メーカ（１）及び実装メーカ（２）が通信網（２８）を介し取り込んで必要な処理を行う際に必要となる情報が含まれることを特徴とする請求項１７記載の回路基板の生産方法。

２０．（補正後）基板メーカ（１）で生産した基板を後続する実装メーカ（２）に流通させ、実装メーカでの部品実装に供することにより回路基板を生産する回路基板の生産方法であって、

各メーカにおける管理及び製造に関する情報を含む識別情報が参照及び記録可能に構成された情報記録部を備えた基板に対し、基板メーカが識別情報を記録して実装メーカに基板を流通させる回路基板の生産方法。

２１．（補正後）基板メーカ（１）で生産した基板を後続する実装メーカ（２）に流通させ、実装メーカでの部品実装に供することにより回路基板を生産する回路基板の生産方法であって、

各メーカにおける管理及び製造に関する情報を含む識別情報が参照及び記録可能に構成された情報記録部を備えた基板に識別情報を記録して、基板メーカが実装メーカに基板を流通させるにあたり、基板メーカ及び実装メーカで、基板に関する生産工程情報と前記情報記録部から読み出した識別情報とを組み合わせ、通信網（２８）を介して接続されたデータ処理センタ（２９）に送信し、データ処理センタにてデータ処理を行って各種データベース（３０）を構築し、基板メーカ及び実装メーカは必要なデータを通信網を介してデータベースから取り込んで必要な処理を行う回路基板の生産方法。

２２．（補正後）基板に情報記録部が備えられ、前記情報記録部に各メーカ（１、２）における管理及び製造に関する情報を含む識別情報が参照及び記録可能に構成された回路基板。